

**龙迅半导体（合肥）股份有限公司**  
**关于发行境外上市股份（H股）备案申请材料**  
**获中国证监会接收的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了境外公开发行股票（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《龙迅股份关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-072）。

公司已根据相关规定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次发行上市的备案申请材料，并于近日获中国证监会接收。

公司本次发行上市尚需满足多项条件，包括但不限于取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会  
2026年1月13日